

聴講  
無料

## 出展者セミナーのご案内

# 次世代プロセスに期待される非接触計測の提案

WEB 事前登録はこちら [www.horiba.com/jp/semicon2017/seminar/](http://www.horiba.com/jp/semicon2017/seminar/)



半導体先端プロセスの評価・解析に応用可能な HORIBA グループの非接触計測をご提案いたします。HORIBA のコアテクノロジーである光技術を利用した粒子解析・元素分析・分子構造解析を測定事例と共にご紹介いたします。

本セミナーでご紹介する計測技術・製品以外に関するご質問・ご要望も歓迎いたします。

### 日時

12月14日(木) 13:40-14:30

### 場所

東京ビッグサイト (東4ホール)  
TechSPOT EXHIBITOR SEMINARS

出展者セミナー  
TechSPOT EXHIBITOR  
SEMINARS



### セミナーにてご紹介する技術

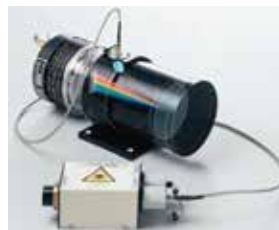
いずれの技術も、お客様のご要望に応じたカスタマイズを実施し、あらゆるアプリケーションに対応可能です。

#### 蛍光X線分析技術



半導体材料の材料判別から液中の元素分析や濃度管理まで幅広く適応します。

#### ラマン分光技術



半導体材料の結晶構造や応力測定など様々なアプリケーションへ適応できます。

#### 粒子計測技術



CMPスラリーの粒子径分布や凝集物を高精度に管理します。

## 株式会社 堀場製作所

本社 / 〒601-8510 京都市南区吉祥院宮の東町2番地 TEL (075)313-8121

[www.horiba.com](http://www.horiba.com)